

**Bruxelles, le 9 septembre 2025
(OR. en)**

**12656/25
ADD 1**

**ENV 815
MI 635
DELECT 125**

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Pour la secrétaire générale de la Commission européenne, Madame Martine DEPREZ, directrice
Date de réception:	8 septembre 2025
Destinataire:	Madame Thérèse BLANCHET, secrétaire générale du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	C(2025) 5939 final - Annex
Objet:	ANNEXE de la directive déléguée de la Commission modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de fusion

Les délégations trouveront ci-joint le document C(2025) 5939 final - Annex.

p.j.: C(2025) 5939 final - Annex



COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 8.9.2025
C(2025) 5939 final

ANNEX

ANNEXE

de la

directive déléguée de la Commission

**modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de
fusion**

ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 7 a) est remplacé par le texte suivant:

«7 a)	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 30 juin 2027.
7 a)-I	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) pour les interconnexions internes destinées à la fixation de puces ou d'autres composants avec une puce dans un assemblage de semi-conducteurs, avec des courants en régime permanent ou transitoires/impulsionnels de 0,1 A ou plus, ou des tensions de blocage supérieures à 10 V, ou des dimensions de bord de puce supérieures à 0,3 mm x 0,3 mm	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027.
7 a)-II	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) pour les connexions intégrales (c.-à-d. internes et externes) de fixation de puces dans des composants électriques et électroniques, si toutes les conditions suivantes sont remplies: - la conductivité thermique du matériau de fixation de puce durci/fritté est $>35\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$; - la conductivité électrique du matériau de fixation de puce durci/fritté est $>4,7\text{MS}/\text{m}$; - la température de solidus est supérieure à 260°C	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027.
7 a)-III	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) dans les soudures de premier niveau (connexions internes ou intégrales - c.-à-d. internes et externes) pour la fabrication de composants, de manière que le montage ultérieur de composants électroniques sur	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le

	des sous-ensembles (p.ex. modules, sous-circuits imprimés, substrats ou soudures point à point) au moyen d'une soudure secondaire ne provoque pas la refusion de la soudure de premier niveau. Cette sous-exemption exclut les applications de fixation de puces et les scellements hermétiques.	31 décembre 2027.
7 a)-IV	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) dans les joints de soudure de deuxième niveau pour la fixation de composants sur des cartes de circuit imprimé ou des cadres de connexion; 1. dans des billes de soudure pour la fixation des matrices de billes BGA (Ball Grid Array) en céramique, 2. dans les surmoulages plastiques haute température (> 220 °C)	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027.
7 a)-V	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) en tant que matériau de scellement hermétique entre: 1. un boîtier ou un connecteur en céramique et un boîtier métallique 2. des terminaisons de composants et une sous-partie interne	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027.
7 a)-VI	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) pour établir des connexions électriques entre des composants de lampe dans les lampes à réflecteur à incandescence pour chauffage infrarouge, les lampes à décharge à haute intensité ou les lampes de four	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027.
7 a)-VII	Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) pour des transducteurs audio dont la température de fonctionnement maximale dépasse 200 °C	S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le

		31 décembre 2027.».
--	--	---------------------